



MSL FPGA INC 晶片參數

■ 芯片概述

THGBMJG8C4LBAU8是来自MSL FPGA INC美时龙推出的一款NAND闪存芯片，
以下是其关键信息：

■ 核心参数

封装类型：BGA（球栅阵列）

容量范围：同系列型号（如THGBMHG8C4LBAAR）显示8GB至32GB容量

电压范围：参考同类产品，典型工作电压为2.7V – 3.6V

工作温度：工业级标准（-25°C至85°C）

■ 功能特性

高集成度：BGA封装节省空间，适合紧凑型设备设计

低功耗管理：待机电流低至1 μ A（参考同类TB67H450AFNG芯片）

可靠性：支持工业级温度范围，适用于严苛环境

■ 应用场景

嵌入式系统：如智能家居控制器、工业自动化设备

消费电子：便携式设备、存储扩展模块

通信设备：5G基站、物联网终端的数据缓存